**2025年，多地筹谋集成电路产业**

来源：中国电子报、电子信息产业网 作者：姬晓婷

近日，全国各省（市）纷纷发布2025政府工作报告，总结2024工作，并提出2025年工作总体要求和重点任务。其中，多地对集成电路产业做出规划。

**北京：推动集成电路重点项目产能爬坡**

2025年1月14日，北京市第十六届人民代表大会第三次会议开幕，北京市市长殷勇作政府工作报告。政府工作报告中指出，2024年北京市人工智能核心产业规模突破3000亿元，集成电路重大项目顺利实施。并提出，2025年将强化科技创新策源功能。加强原创性引领性科技攻关，构建以国家实验室为引领的央地协同创新体系，大力推进集成电路、生物医药等九大专项攻关行动，围绕新能源、合成生物等领域再布局一批新型研究创新平台。提升优势产业发展能级。完善新一代信息技术、人工智能等产业支持政策，推动集成电路重点项目产能爬坡，在新能源整车及零部件等领域推进一批重大工程，聚焦绿色能源等重点产业谋划打造一批新的万亿级产业集群。

**上海：优化集成电路产业空间布局**

1月15日，上海市第十六届人民代表大会第三次会议开幕，市长龚正作政府工作报告。报告中提到，2024年上海市集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达到1.8万亿元。

上海市在政府工作报告中提出，2025年将推动产业转型升级，着眼产业高端化，深入实施三大先导产业新一轮“上海方案”，优化集成电路产业空间布局，全链条加速生物医药产业创新发展，加快推进人工智能产业创新高地建设，培育壮大低空经济、大飞机、新能源汽车、智能终端、海洋装备、空间信息、机器人等战略性新兴产业和未来产业，健全保持制造业合理比重投入机制。

**广东：打造中国集成电路第三极**

1月15日，广东省第十四届人民代表大会第三次会议举行，省长王伟中作政府工作报告。报告中提到，2024年广东省加快推进新型工业化，围绕集成电路、人工智能、低空经济、生物医药、商业航天等领域逐个出台支持政策，集中资源培育一批战略性新兴产业，实施未来产业集群行动计划，集成电路产量增长21%、占全国18%。

2025年广东省将加快发展新兴产业和未来产业。整合科技创新资源，优化战略性产业集群发展体系，培育更多国家先进制造业集群。大力发展集成电路、新能源汽车、人工智能、低空经济、新型显示、新型储能、新材料、生物医药等新兴产业，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业，打造国家新型工业化示范区，争创国家未来产业先导区。

广东省还将实施“百链韧性提升”专项行动。落实制造业重点产业链高质量发展行动，深入推进“广东强芯”、核心软件攻关、“璀璨行动”等工程，打造中国集成电路第三极。

**辽宁：做大做强集成电路等10个战略性新兴产业**

1月16日，辽宁省第十四届人民代表大会第三次会议举行，省长李乐成作政府工作报告。报告中提到，2025年将培育壮大新兴产业和未来产业。做大做强机器人、集成电路装备、生物医药等10个战略性新兴产业。大力发展通用航空和低空经济。实施“人工智能+”行动，加快建设数字辽宁、智造强省。统筹布局算力中心，加快公共数据资源开发利用，壮大软件、工业互联网、区块链等数字产业。

**山西：推动集成电路等数字经济核心产业增长10%以上**

1月17日，山西省第十四届人民代表大会第三次会议举行，省长金湘军作政府工作报告。报告中表示，山西省2025年将推动数字经济和实体经济深度融合，推动大数据、集成电路、智能终端等数字经济核心产业增长10%以上。开展“人工智能+”行动，打造“5G+工业互联网”产业集群和创新生态，搭建跨行业综合性数字化赋能平台，新创建智能工厂30户，两化融合指数达到92。

**沈阳：加快建设“北方芯谷”**

1月12日，沈阳市第十七届人民代表大会第四次会议举行，市长吕志成作政府工作报告。报告中指出，2024年沈阳市集成电路产业产值增长45.9%。2025年沈阳市将着力促进新兴产业跃升，持续壮大集成电路产业，加快建设“北方芯谷”**。**

**无锡：加快推进华进半导体、芯卓二期等112个重大项目**

1月11日，无锡市第十七届人民代表大会第四次会议举行，市长赵建军作政府工作报告。报告中指出，无锡市2024年组建总规模120亿元的集成电路、生物医药、未来产业、低空经济和空天产业4只政府性专项基金，集成电路“核心三业”比例更趋优化，设计业全国排名上升一位，建成华虹无锡基地二期等一批重大晶圆制造项目，封测业承担更多战略任务，设备业营收增长超30%，入选省重大产业项目中集成电路领域占1/3。

2025年无锡市将放大集群建设显示度，聚力物联网“一感两网”建设，积极发展高性能MEMS、多模态融合感知、智能视觉等传感器，全面完成“车路云一体化”基础设施和云控平台建设，升级工业互联网平台，更好擦亮“物联网之都”产业名片。推动集成电路“一二三四五”发展路径走深走实，聚焦先进封装、特色工艺、国产装备等重点领域为全局构筑战略支撑，持续引育拓展芯片设计、IDM、第三代半导体项目和细分领域头部企业，加快推进华进半导体、芯卓二期等112个重大项目，建强半导体装备与关键零部件创新中心，争创国家战略性新兴产业集群。大力开展“人工智能+”行动，针对性发展集成电路、医药研发、高端装备、纺织服装等行业大模型，支持雪浪工业大模型打造应用标杆，支持落地开发各类智能体平台。